

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> : <b>G06K 19/077, B29C 45/14, C09J 5/06</b>	<b>A1</b>	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 00/25264</b> (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: <b>4. Mai 2000 (04.05.00)</b>
--	-----------	---

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP99/07683**  
(22) Internationales Anmeldedatum: **13. Oktober 1999 (13.10.99)**  
(30) Prioritätsdaten:  
198 48 712.6      22. Oktober 1998 (22.10.98)      DE  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): **HENKEL  
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [DE/DE];  
Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).**  
(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **WÜSTRICH, Liane  
[DE/DE]; Krischer Strasse 79, D-40789 Mönheim (DE).  
RANFT, Paul [DE/DE]; Lodenheide 34, D-40724 Hilden  
(DE). GRÜTZNER, Jürgen [DE/DE]; Bitburger Strasse  
35 a, D-47259 Duisburg (DE). KOLB, Uwe [DE/DE];  
Vogtlandstrasse 16, D-71111 Waldenbuch (DE).**

(81) Bestimmungsstaaten: **CA, JP, KR, US, europäisches Patent  
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,  
LU, MC, NL, PT, SE).**

**Veröffentlicht**

*Mit internationalem Recherchenbericht.  
Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen  
Frist: Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen  
eintreffen.*

(54) Title: **HOT-MELT ADHESIVE COMPONENT LAYERS FOR SMART CARDS**

(54) Bezeichnung: **KOMPONENTENSCHICHT FÜR SMART CARDS AUS SCHMELZKLEBSTOFFEN**

(57) Abstract

The invention relates to the utilization of thermoplastic hot melt adhesives for the production of component layers in smart cards or for the production of electronic transponders with the aid of a low pressure injection molding process at pressures ranging between 1 and 50 bar. Preferably, hot melt adhesives based on polyamide, polyurethane, polyester, atactic polypropylene, EVA copolymers or low molecular weight ethylene copolymers or the mixtures thereof are used in said method.

(57) Zusammenfassung

Es wird die Verwendung von thermoplastischen Schmelzklebstoffen zur Herstellung von Komponentenschichten in Smart Cards oder zur Herstellung von elektronischen Transpondern mit Hilfe eines Niederdruck-Spritzgußverfahrens bei Drücken zwischen 1 und 50 bar beschrieben. Vorzugsweise finden für dieses Verfahren Schmelzklebstoffe auf der Basis von Polyamid, Polyurethan, Polyester, ataktischem Polypropylen, EVA-Copolymeren oder niedermolekularen Ethylen-Copolymeren oder deren Mischungen Verwendung.

# LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						